

Microprobe将持续加大投资以服务中国客户



的维护将是获得成功的三个关键标准。

SI China: 今年Microprobe将呈现给中国用户哪些新产品、新技术?

Mike Slessor: 我们目前推出的Vx-RF-80探针卡定位于高速(3-6GHz)晶圆测试应用领域,是我们持续提高技术能力和控制拥有成本努力下的最新产品。Vx-RF-80运用了Microprobe创新的基于MEMs的探针技术,通过提升客户的良品率和延长探针卡的使用寿命,为客户节省了两倍的测试成本。随着3G以及802.11无线技术的发展以及越来越多的晶圆级封装应用,高性能并同时具有成本效益的晶圆测试需求在不断增长,Vx-RF-80为其提供了一个最佳的性能/成本晶圆测试解决方案。目前越来越多的客户已经开始认识到我们Vx技术平台在性能和成本方面的优势,随着3G网络在中国的推广,我们预期Vx-RF-80将会被中国无线芯片领域的客户及其制造伙伴广泛采用。

SI China: Microprobe针对不同的细分市场会有哪些解决方案?

Mike Slessor: MicroProbe的产品主要参与非记忆体晶圆测试市场,包括Logic、RF和系统芯片(SOC)的应用。在所有这些应用领域,我们仍将致力于投资新项目以提高我们产品的性能,并且为客户降低产品的拥有成本。

在提高产品性能方面,Vx-RF-80展示了我们基于MEMs的Vx技术平台扩展到了新的应用领域。这帮助我们的客户实现了提高性能和降低拥有成本的目标,正如我们缩小探针节距以有利于包装,提高电气性能以提高客户收益,并加强探针卡的坚固性和延长使用寿命以降低成本。伴随着这项新技术,Microprobe在中国及全球其他市场上仍将为客户提供我们的传统的cantilever和vertical Apollo技

Microprobe CEO Mike Slessor在日前接受《半导体国际》采访时表示,对于探针卡公司而言,为了达到更好的并行测试以跟随ATE设备不断提升的吞吐率,以及随着器件集成更高带宽功能需要测试更高的频率,更高的测试效率、更低的成本和更少的

术(悬臂和垂直探针卡),以帮助他们优化成本/性能的控制点。我们特别希望看到Apollo vertical(阿波罗垂直)产品能参与更多的各式各样的芯片规模封装(CSP)的应用,并且看到我们的cantilever(悬臂)产品继续从LCD驱动器到复杂的SOC测试等各领域的应用。对此,我们的苏州工厂会更加有效和高效地服务于本地客户。

SI China: MicroProbe在测试探针卡领域主要竞争力是什么?

Mike Slessor: 我们三个关键举措,以确保在探针卡市场占有一个强有力的竞争地位。首先,我们在技术方面持续创新,提供给客户能应对当前的晶圆测试的性能和成本挑战的产品,同时还致力于投资能满足客户未来长远目标的研究。Vx-RF-80的推出,其市场领先的电气性能,对拥有成本2倍的改进,扩展到40um的节距,都很好的说明了它是产品创新领域的关键成果之一。再加上我们的传统的cantilever和vertical的产品线,MicroProbe为广泛的客户群体提供了应对晶圆测试挑战的解决方案。其次,我们推行全球扩张的策略,特别是在中国、台湾地区和东南亚地区以支持我们客户群的扩大。我们在苏州投资了制造工厂,在台湾新竹设立了服务及维修中心。这些投资项目使我们能够对我们的客户的需求做出快速的反映,无论是服务和维修方面的问题,还是新产品快速的交货时间。

再次,我们关注MicroProbe的增长和盈利能力,以保证我们能够继续推行前两个政策。不久前我们蝉联了德勤颁发的高成长50强奖项,再次肯定了我们一贯的盈利和成长性。另一个更直观的方面是我们拥有强大的机构投资者支持,像Flywheel Ventures、Intel Capital 和Gemini Investors等。

SI China: 苏州工厂目前在Microprobe全球业务中承担的角色是什么?

Mike Slessor: MicroProbe苏州是我们全球扩张和提高生产效率举措中的一个关键因素。目前客户要求的出货时间及反映时间都在缩短,技术能力要求则不断提高,我们将继续努力满足这些要求。当地的资源,如美博科技苏州公司,在地理和文化上更接近客户,使得我们以最迅速和符合成本效益的方式服务客户成为可能。随着我们的强劲增长和持续盈利,同时凭借我们机构投资者的有力支持,我们认为2009年的市场挑战为我们在这地区的扩展提供了机遇。